



致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining

深圳市青虹激光科技有限公司

致力于激光精密加工解决方案



目录

致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining

1

公司简介

P A R T Company Profile

2

发展历程

P A R T Development
Milestone

3

企业文化

P A R T Company Culture

4

核心能力

P A R T Core Competence

5

行业定位

P A R T Industrial Position

6

解决方案

P A R T Product & Solution

7

荣誉资质

P A R T Honor Certificate

8

合作伙伴

P A R T Cooperation Partner



致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining

01 企业简介

C o m p a n y P r o f i l e



企业简介

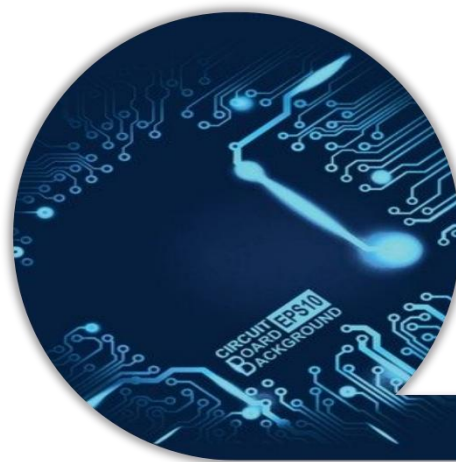
致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining

成立时间	Established	2018年2月6日
企业规模	ccctime	注册资金：1,020.4万元 员工：>200多人(研发人员占比>50%) 营收：2019年0.6亿元, 2020年1.1亿元
主营业务：	ccctime	激光精密加工成套设备
技术研发：	ccctime	国家级高新技术企业 截止2020年底已申请有数十项实用新型专利及十余项发明专利和软件著作权



最资深技术团队

- 团队涵盖机械、电控、软件、光学工艺等各学科专家。
- 团队各学科带头人均来自国内知名上市企业的研发总监以上学科带头人，具有15年以上激光行业从业经历。
- 曾开创了国内半导体晶圆划片、蓝宝石视窗片切割、显示面板激光微0加工等激光精密加工设备的先河。国内首批苹果公司所使用的高端激光精密加工设备为该团队开发。



专注激光精密加工

- 立足于激光精密加工。
- 专注为光伏、电路板、半导体行业提供业界最具竞争力解决方案。
- 青虹激光持续的保持高研发投入，助力行业的创新升级。



大客户服务体系

- 始终坚持以客户为中心，以最优的技术，最好的服务，提供最符合客户需求的解决方案。
- 从售前支持、产品研发到售后服务，完备健全的大客户服务体系，持续的为客户创造价值



发展历程

Development Milestone



发展历程

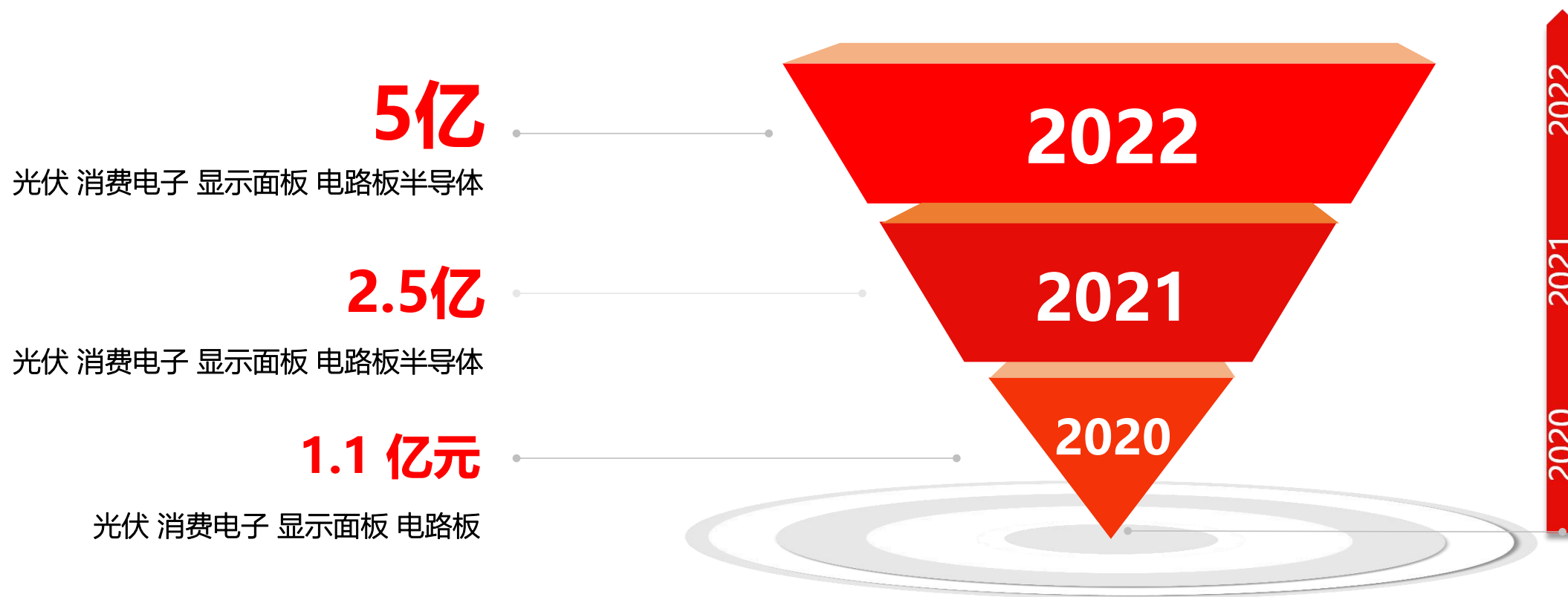
致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining





市场销售预测

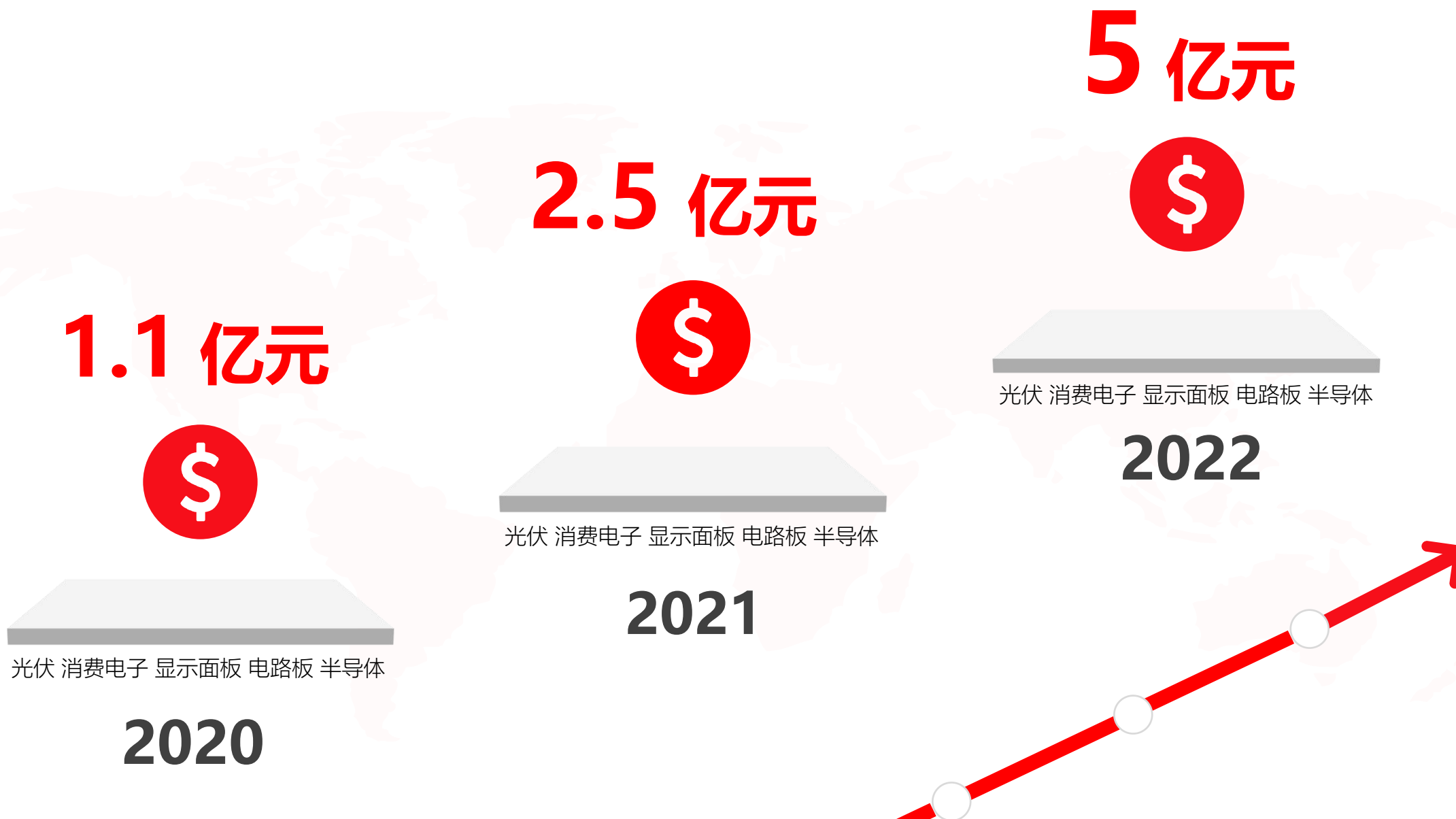
致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining





市场销售预测

致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining





企业文化

Company Culture



核心价值

为客户创造价值
带动行业进步



企业愿景

中国高端装备领导者
国外进口装备替代者
客户价值创造者

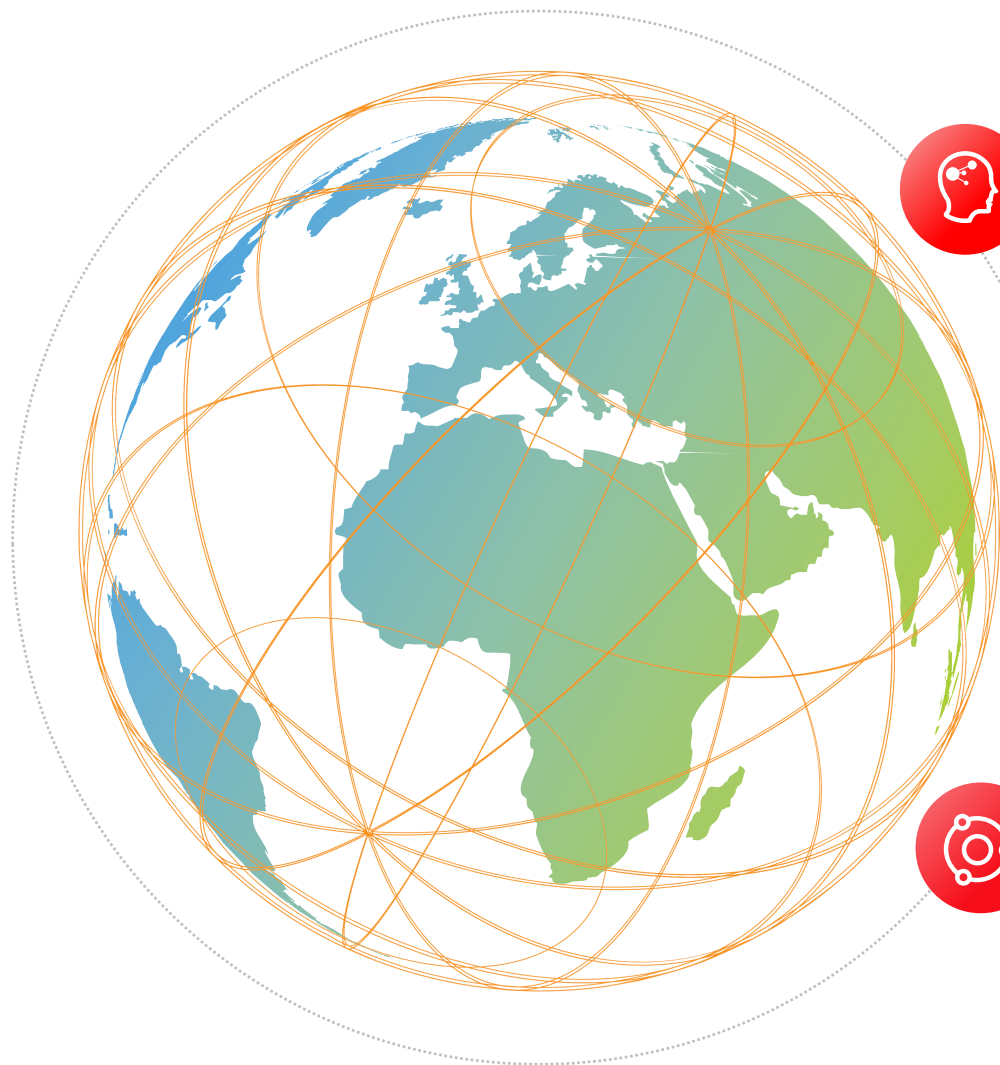
企业使命

以客户为中心，以奋斗者为本
成就他人，勇于担当，成功共享



企业文化

致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining



核心价值

为客户创造价值，带动行业进步



企业使命

以客户为中心，以奋斗者为本成就他人，勇于担当，成功共享



企业愿景

中国高端装备领导者、国外进口装备替代者、客户价值创造者



核 心 能 力

Core Competence



核心能力

致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining

自动化
自动化整线设计能力
为各行业客户量身定制

软件系统

完备的软件开发团队，确保核心
控制软件全自主研发
软件自主开发更贴近客户的需求

服务体系

华为式大客户服务体系
端到端的客户服务团队

光学工艺

团队具有业界领先的激光精密切
割、打孔等外光学模组设计能力
公司拥有业界经验最丰富的光学
工艺工程师团队





行业解决方案	消费电子		半导体	电路板	光伏行业	显示面板		
产品系列								
	皮秒切割机		玻璃打孔机	激光标刻机	刀轮划片机	激光划片机		
青虹软件平台	激光打孔软件 · 视觉检测软件 · 激光切割软件 · 激光蚀刻软件 · 激光3D测量软件 · AI智能算法							
青虹硬件平台	精密光学系统			精密电控系统		精密机械系统		
	<ul style="list-style-type: none">精密振镜扫描方头贝塞尔聚焦头隐形聚焦切割头晶体分光光路平顶光整形光路打孔光路系统.....			<ul style="list-style-type: none">激光功率反馈系统AF自动对焦系统机器视觉系统位移传感测量平台插补运动控制上下料逻辑控制精密振镜控制.....		<ul style="list-style-type: none">大理石底座结构气浮减震隔离结构直线电机平台精密中控旋转.....		
基础零部件								
	激光器	振镜	切割头	电机	气动	机床平台	PLC	工控机



服务网络

致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining

青虹激光建立起了完善的市场服务体系，在国内多个省市设立服务分支机构，全覆盖的销售服务网络确保了青虹对客户需求的及时响应。

□ 售后服务

- 设备的安装、调试，免费的客户技术人员培训和认证，保障后期的顺利生产。
- 一年质保，终身维保，质保期内设备故障及器件损坏免费维修（人为因素及不可抗力因素除外）
- 接到用户报修申请，2小时内售后服务响应，24小时内明确答复或到达设备现场。
- 持续的软件升级服务，提供终身软件免费升级服务



□ 售前服务

- 专业技术咨询：提供关于产品、技术、行业解决方案等方面的信息咨询，可提供定制化的客户解决方案。
- 样品打样服务：提供打样服务，并提供专业的分析报告。
- 参观接待服务：公司展厅、研发实验室、生产车间等现场考察



行 业 定 位

Industrial Position



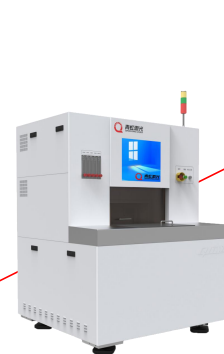
行业定位

致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining



光伏行业

- ✧ 光伏背板玻璃打孔
- ✧ 光伏玻璃尺寸测量
- ✧ 光伏电池片无损切割



半导体行业

- ✧ 晶圆激光划片裂片
- ✧ 晶圆激光打码
- ✧ 晶圆刀轮划片
- ✧ 条状IC激光标刻
- ✧ SIP封装芯片开槽



电路板行业

- ✧ PCB/FPC激光切割
- ✧ FPC激光开窗
- ✧ PCB激光打码
- ✧ 载板PNL激光打码



消费电子行业

- ✧ 玻璃切割、打孔
- ✧ 蓝宝石切割、打孔
- ✧ 陶瓷切割、打孔
- ✧ 激光标识、内雕微码
- ✧ 激光去除油墨、PVD





行业定位

致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining

光伏行业



- ◇ 光伏背板玻璃打孔
- ◇ 光伏玻璃尺寸测量
- ◇ 光伏电池片无损切割

半导体行业



- ◇ 晶圆激光划片裂片
- ◇ 晶圆激光打码
- ◇ 晶圆刀轮划片
- ◇ 条状IC激光标刻
- ◇ SIP封装芯片开槽



电路板行业



- ◇ PCB/FPC激光切割
- ◇ FPC激光开窗
- ◇ PCB激光打码
- ◇ 载板PNL激光打码



消费电子行业



- ◇ 玻璃切割、打孔
- ◇ 蓝宝石切割、打孔
- ◇ 陶瓷切割、打孔
- ◇ 激光标识、内雕微码
- ◇ 激光去除油墨、PVD



行业解决方案

Product & Solution



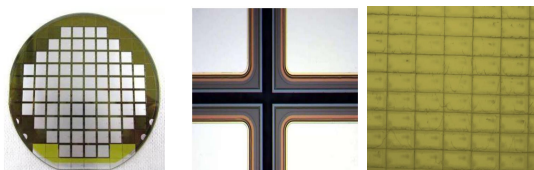
电路板行业解决方案

致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining

晶圆激光划片



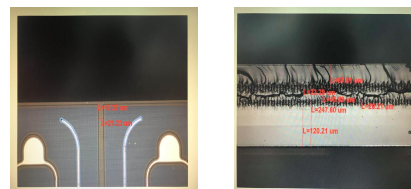
晶圆激光划片机应用于LED/Si/SiC晶圆的内改质划片，是一种无人值守全自动运行、高精度、高效率的切割设备。



全自动划片



全自动裂片机主要应用于LED或半导体行业的SiC、Si、GaN、蓝宝石等脆性材料wafer划片后的分裂作业，也可用于其它半切产品，如玻璃、陶瓷、特殊金属材质wafer的裂断作业。



晶圆激光打码

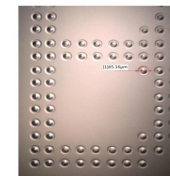
用于晶圆ID号标记

用于晶圆DIE号标记

适用于Si/GaAs/SiC/ GaN等材料



Si晶圆ID



晶圆DIE

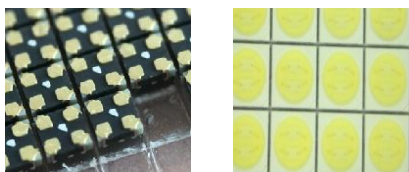


半导体行业解决方案

致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining



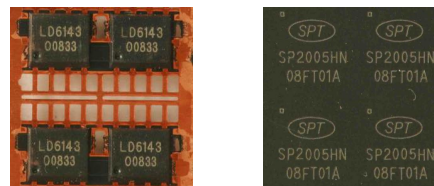
LED晶圆划片机应用于LED晶圆的内改质划片，是一种无人值守全自动运行、高精度、高效率的切割设备



晶圆刀轮划片



全自动IC激光标刻机是对半导体行业IC、AC引线框架封装前后进行各种激光标刻的设备。该设备通过电动调节可适用不同的尺寸基板线框架，可对接客户Mapping数据、支持SECS/GEM通信



PCB激光开窗/揭盖



青虹激光独创的LRP技术，该技术实现了各种形状开槽的快速激光成型。

- 激光开槽: T型槽、I直通槽、V型槽、Y型槽
- 外形（异性）切割
- 激光标识



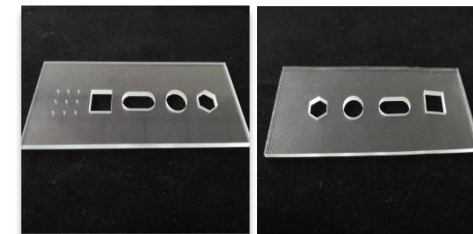
PCB载板打码



光伏背板玻璃打孔



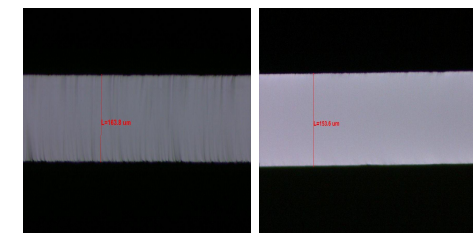
在线式光伏背板玻璃自动化钻孔系统，
7×24h连续无人生产，相比传统机械加工，具有加工良率高、生产效率高、节省人力的特点。



光伏电池片无损切割



- ✧ 铝背场及单/双面PERC太阳能电池
- ✧ TOPCon太阳能电池
- ✧ HJT异质结太阳能电池



微损切割

无损切割



PCB/FPC激光切割



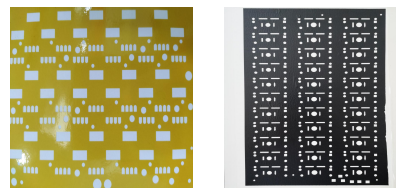
- ✧ PCB、FPC分板切割
- ✧ 指纹芯片等IC芯片切割
- ✧ 摄像头模组切割



PCB激光开窗/揭盖



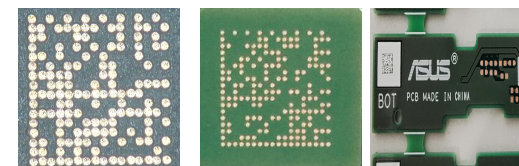
- ✧ 覆盖膜开窗、揭盖
- ✧ 覆盖膜卷对卷、卷对片或片对片加工
- ✧ OLED模组分切、全面屏切割



PCB载板打码



主要应用于PCB载板白油、绿油、黑油、红油等多种油墨表面激光打码，通过将生产过程、产品批次、生产日期等信息转换为明码或二维码，实现对产品的追溯和管理。





激光玻璃切割



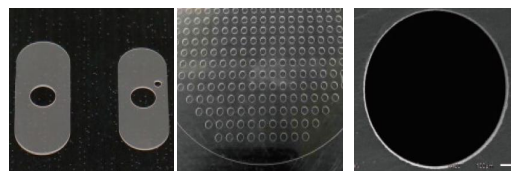
- ✧ LCD全面屏切割
- ✧ 玻璃/蓝宝石摄像头盖板切割
- ✧ 医疗/家电/车载玻璃切割
- ✧ 穿戴产品盖板切割
- ✧ 滤光片切割



PCB激光开窗/揭盖



- ✧ 蓝宝石材料打孔
- ✧ 屏幕盖板玻璃打孔
- ✧ 光学玻璃打孔
- ✧ 厨卫家居玻璃打孔



PCB载板打码



G8.5代TFT-LCD显示面板激光在线打码设备。





荣誉资质

Honor Certificate



荣誉资质

致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining



• 公司通过三年的技术创新，形成了多项重要技术成果，申请十余项发明专利、数十项实用新型专利和计算机软件著作权



PART. 08

合作伙伴

Cooperation Partner



“以客户为中心、持续为客户创造价值”



依顿电子



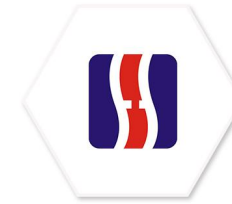
京东方



深南电路



美维



胜宏科技



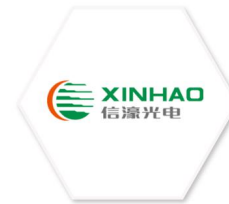
景旺电子



比亚迪



广合



信濠



士兰微电子



维信电子



沪士电子



闻泰科技



讯芯电子



联创电子



致力于激光精密加工解决方案
Committed to Laser Micromachining

THANKS

感谢您的观看

致力于激光精密加工解决方案

Committed to Laser Precision
Machining Solutions

青虹激光

Qinghong Laser